



多様な未来に貢献する原子拡散接合

原子拡散接合装置 BC7000/BC7300シリーズ



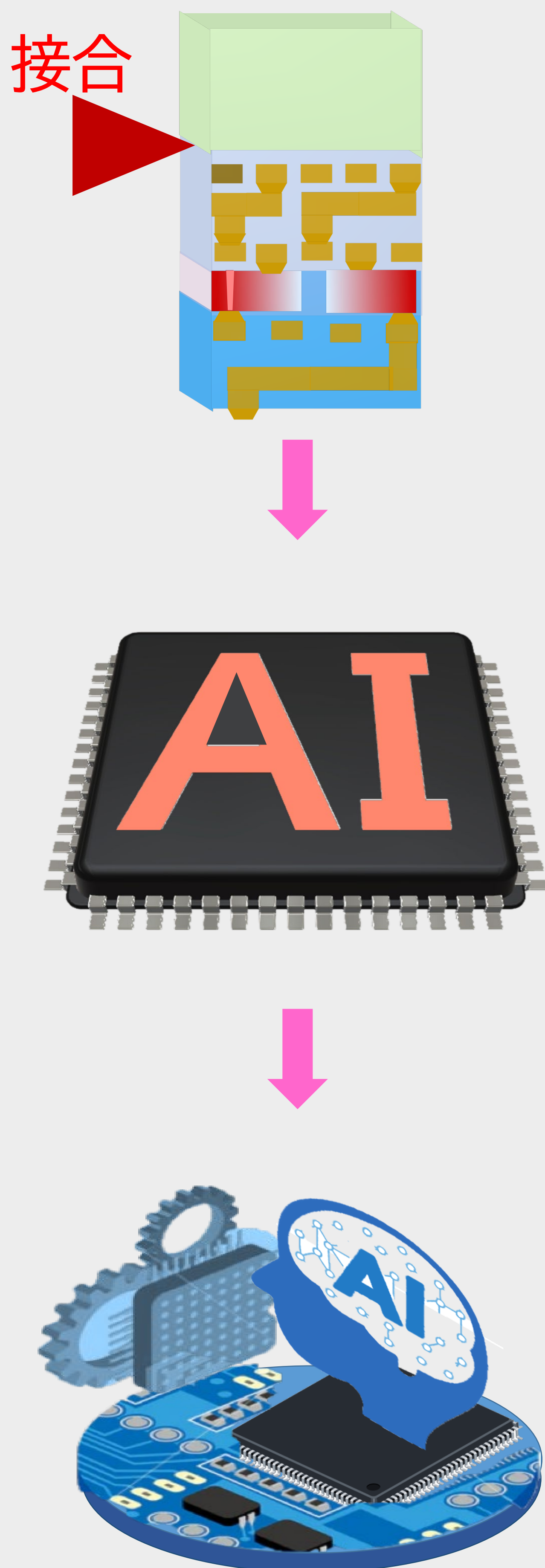
【BC7300】

特 長

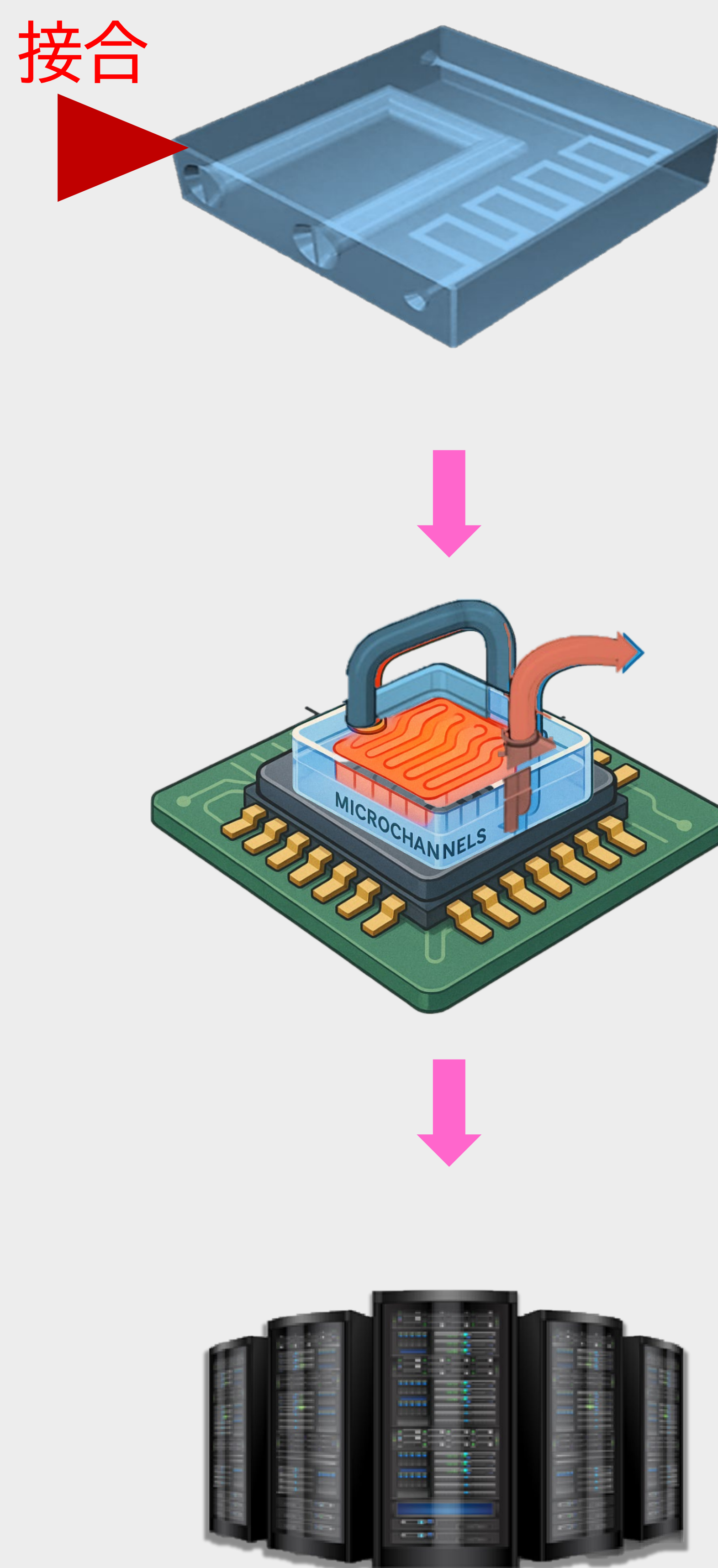
- ✓ 接合時加熱・加圧が不要
- ✓ ウエハの材質によらず強固な接合が可能
- ✓ スパッタ膜により接合界面に多彩な機能を付加することが可能
- ✓ 超高真空プロセスによって得られる清浄な界面が、強固な接合を可能

【接合用途例】

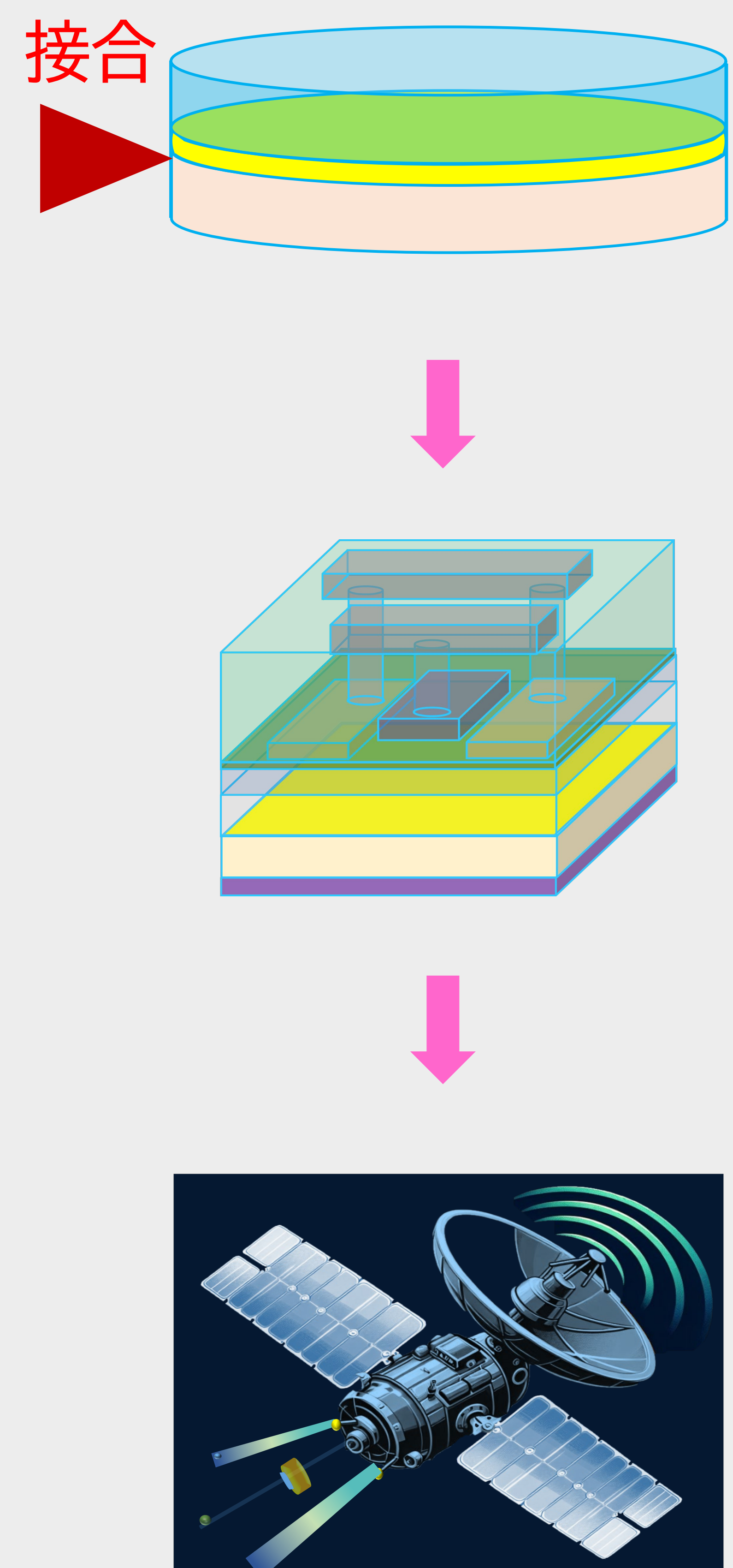
【先端LSI】



【マイクロ流路】



【化合物・POWER】



Canon

CANON ANELVA CORPORATION



接合技術を加速させるソリューション

PLABAS¹⁾ Dual Cathode (PDC)搭載 スパッタリング装置

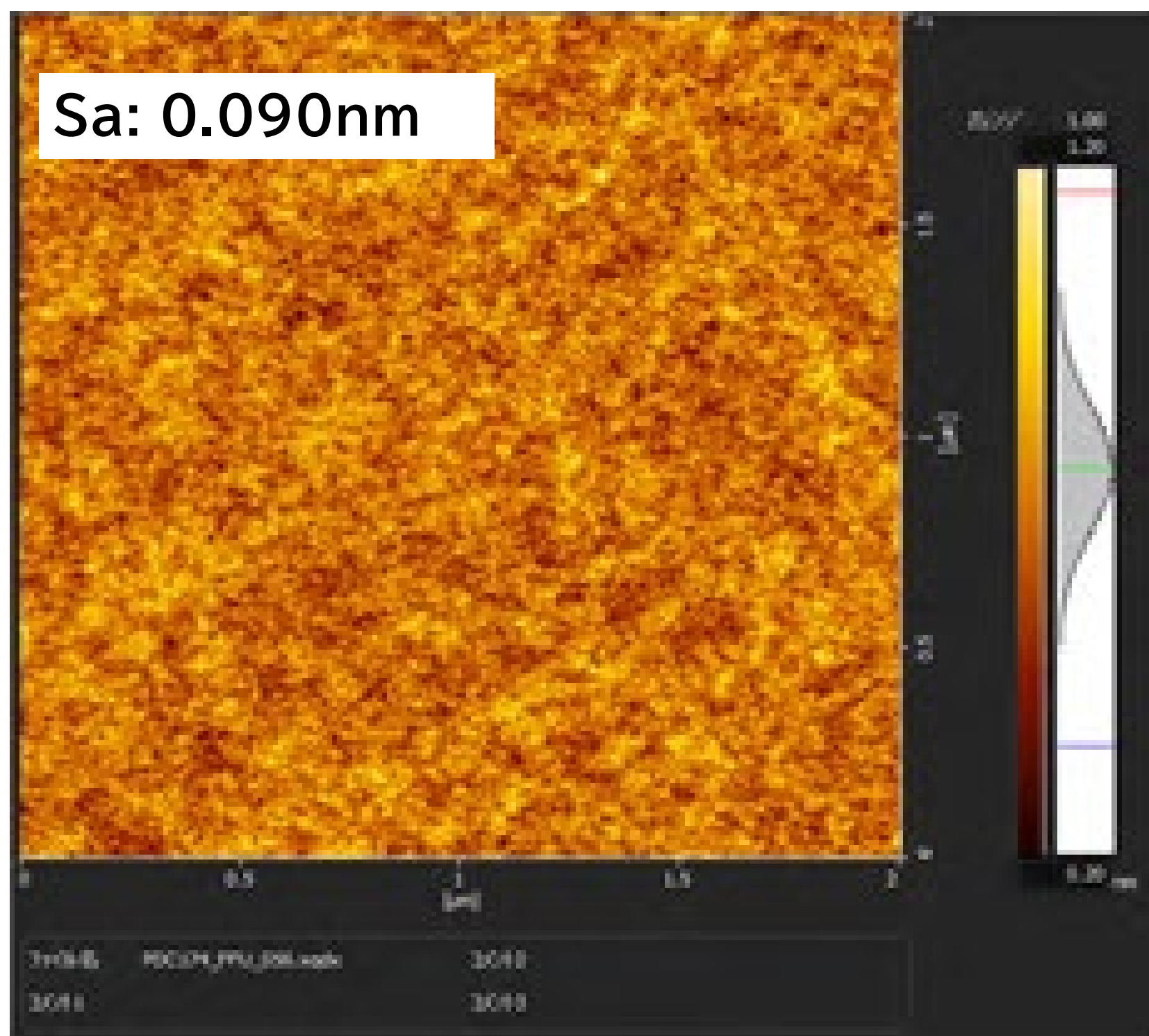
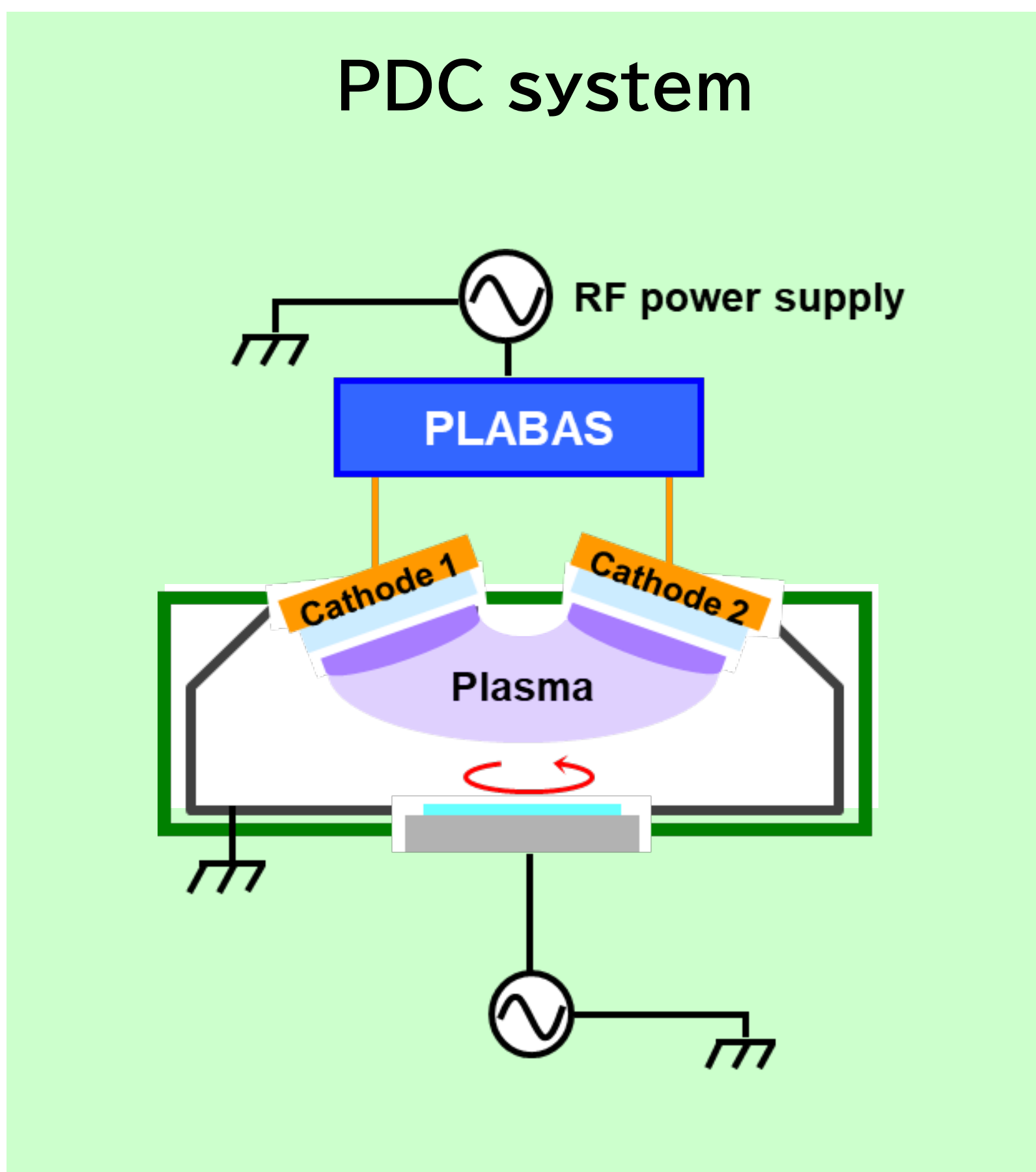
1) Plasma Balanced System



【EC7430】

特長

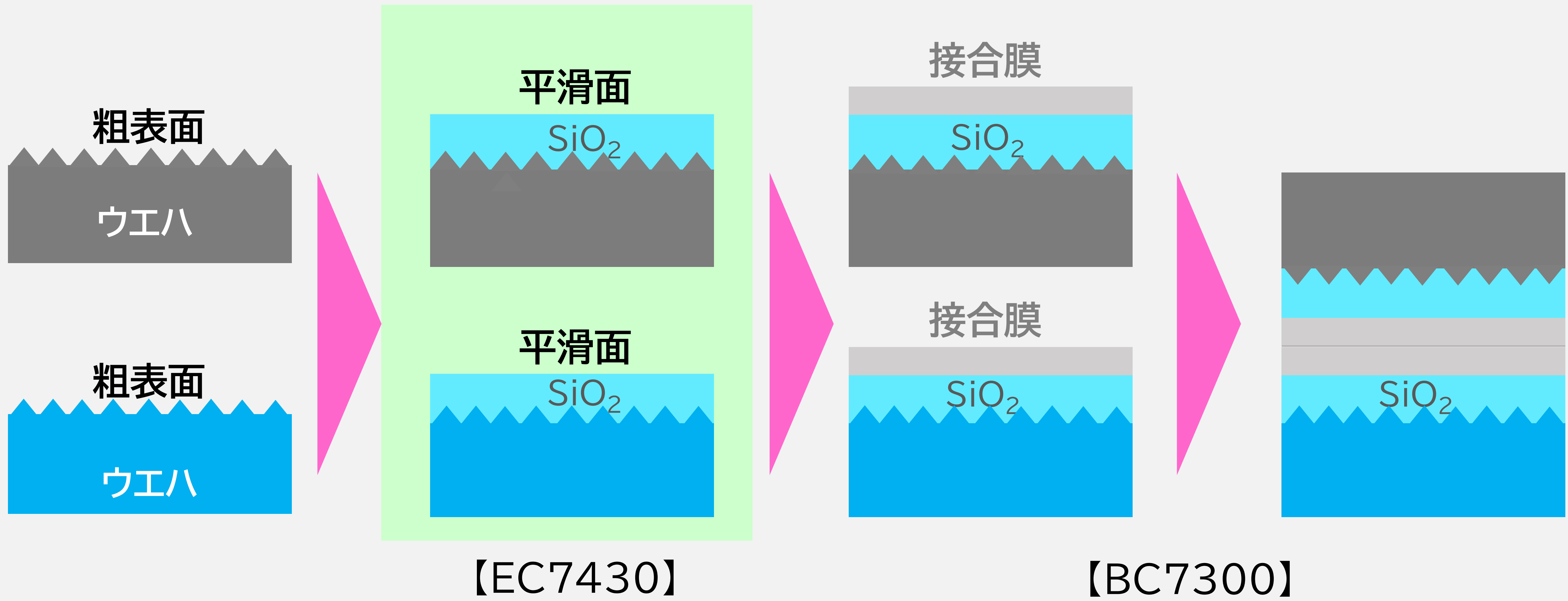
- ✓ 誘電体成膜時もプラズマの状態変化が小さい、安定した成膜を実現
- ✓ 高成膜速度と面内均一性の両立
- ✓ カソード/基板バイアスの干渉が少ない安定制御
- ✓ 接合性に優れた、平滑な膜を形成



SiO₂膜の表面のAFM像

【接合との組み合わせフロー】

成膜後のCMPなしでも、強固な接合が可能



Canon

CANON ANELVA CORPORATION